自己組織化材料の半導体微細パターニングへの応用

Application of Self-Assembly Materials to Semiconductor Patterning

生井準人 Hayato Namai

杉田 光 Hikaru Sugita

日城良樹 Yoshiki Hishiro

Joy Y. Cheng

Daniel P. Sanders Robert D. Allen

Directed self-assembly (DSA) technique is one of the promising techniques to achieve high resolution patterning for future semiconductor manufacturing-18-nm half pitch and beyond. In this paper, polymerblend DSA is proposed as an alternative lithographic concept because of the potential lower process cost, wider material selection, and easier reaction control in mass production, compared to block-copolymer DSA. Block copolymer DSA has been widely studied due to the intrinsic potential to offer ordered phaseseparation structure; sphere, cylinder, gyroid, and lamella. Polymer-blend DSA has very high potential for ordered phase-separation structure formation, such as 19-nm line patterns with favorable roughness, uniformity, and low defects, which are demonstrated by sophisticated molecular design and process optimization. These results were key in opening a new door of ultimate resolution lithography.

1 緒言

半導体業界はこれまで、Mooreの法則を基に設定され た国際半導体技術ロードマップ(ITRS)に則って微細化を 進めてきた.しかし、実用性を考慮すると、シングル露光 では36nmハーフピッチを境に、ダブル露光や側壁プロセ ス等の特殊プロセスとの組合せでも18nmハーフピッチを境 に大きな技術障壁に直面しており、材料とプロセスの両面 からブレークスルーが望まれている.これを実現すべく, 極端紫外線(EUV)技術,電子線(EB)技術,ナノインプ リント(NIL)技術,自己組織化技術等が次世代リソグラ フィーの候補として盛んに研究されている。今回,著者ら は自己組織化材料を用いた微細パターニングに成功した ため報告する.

自己組織化技術とは、分子間相互作用の巧みな制御 によって、規則構造を有する分子集合体を自発的に発現 させる方法であり、自然界ではDNAやタンパク等の生体 分子に代表される. 近年ではポリマーを用いた自己組織 化も盛んに研究が行なわれており、極めて精密な構造制 御が実現されている^{1),2),3),4),5),6),7)}.例えば,名古屋大学 の松下らは3元スターポリマーの自己組織化により、2011年 のノーベル化学賞である準結晶構造の形成をポリマーで 実現している。自己組織化技術を半導体用途に応用し た場合、ポリマーの自己配列によるコンタクトホールやライン アンドスペースパターンの形成がターゲットとなる.本応用 方法は1997年にプリンストン大学のグループによって提案さ れた⁹. 半導体業界では、ガイドパターンの「誘導」による ポリマーの配向制御を必要とするため、特に誘導自己組 織化(Directed Self Assembly, DSA)技術と呼ばれる. 光を必要としないDSAでは光学的な解像限界は存在せ ず、ポリマーサイズによって解像限界が決定される. 故 に,理論上,数十nmから数nmまでのパターン形成が可 能であるため、そのターゲットはArF液浸以降の全てとなり うる. すなわち、上記のEUV技術、EB技術、NIL技術と は対抗馬の関係にある一方で、更にその先の微細化をも 実現しうる技術である.

半導体業界におけるDSA技術は、ブロックコポリマーが 有する規則的なミクロ相分離能を利用した研究例が大半 である. 互いに非相容な2つのポリマー成分が化学結合で

連結されたジブロックコポリマーは、同一ポリマー成分同 士が分子間集合することでミクロ相分離を起こす.この 際,2つのポリマー成分間の分子鎖長比(f)に応じて集合 時の界面曲率が変化する.結果,球状構造,シリンダー 構造、ジャイロイド構造、ラメラ構造といった規則的なモル フォロジーを与える(図1)10. この規則構造が半導体微細 パターニングに好適となる. つまり, ミクロ相分離構造から 一方のポリマー成分を選択除去することで、シリンダー構 造(場合によっては球状構造)はコンタクトホールパターン を、ラメラ構造はラインアンドスペースパターンを形成す る. その際, ポリマーの分子鎖長によってパターンサイズ は決定される. すなわち, 低分子量化および狭分散化を 図ることで、サイズばらつきを制御した微細パターンの形成 が理論上可能となる.しかし、ジブロックコポリマーを用い て平面基板上にラメラ構造を形成しても、理想的な直線 配向にはならない. 各ミクロドメイン間の配向制御能力は限 られるため、指紋様のランダム配向となる(図2a).また、 基板に対して垂直ラメラ構造を与えるとも限らず、平行ラメ ラ構造を与えることもある. そこで、ガイドパターンや基板 の表面エネルギー制御によって、このランダム配向を所望 の位置に垂直ラメラの直線配向になるよう「誘導」することが 必要になる(図2b). これが誘導自己組織化(DSA)と呼 ばれる所以である. ガイドパターンによる「誘導」の概念は 2000年前半から多く提案され始め11),12),13),その方式に応 じて2種に大別される. グラフォエピタキシーとケミカルエピ タキシーである.前者はレジストパターン等による立体ガイ ド,後者は表面改質等による平面ガイドである.近年で は、これらガイドパターンを含め、下地の表面処理等,配 向制御に注目した研究例が増加している.例えば、マサ チューセッツ工科大学のRossらは柱状ガイドパターンを用 いた配向制御を提案しており、柱状パターンの周期・配列 変化によりブロックコポリマーの配向を巧みに「誘導」してい る(図3)¹⁴.このように、ブロックコポリマー型DSA技術は 大きな可能性を秘めているが、一方で課題も多い.高温 ベークやドライ現像等の特殊なプロセスが必須な系も多 く、その場合、プロセスコストが割高となる.また、分子量 と分散度がパターンサイズとサイズばらつきに直結するた め、生産時の僅かな「ぶれ」が性能に大きく影響する.材 料設計面においても、合成可能な構造が限定されるため 材料選択幅が広いとは言えない.

そこで著者らはポリマーブレンド型のDSAに着目した. 異種ポリマーの混合という概念はポリマーアロイ等で古くか ら知られている.しかし,これを微細パターニングに応用 した研究例はほとんどない.これは、ブロックコポリマー対 比で配向制御の障壁が遥かに高いことが理由と考えられ る.ポリマーブレンドはブロックコポリマーと異なり、2つのポ リマー成分間に化学結合がないため規則的なミクロ相分離 構造を自発的に与えることはない.結果,水-油の相分離 様の無秩序構造を与える(図4).数少ない例の一つとして マサチューセッツ大学のMeadらの研究を紹介する



Figure 1 A representation of the equilibrium microdomain structures of linear diblock copolymers.



Figure 2 SEM images of typical perpendicular lamellar morphology of diblock copolymers (a) without guide patterns, and (b) with guide patterns.



Figure 3 Examples of the recent DSA work with circular post guide patterns by the Massachusetts Institute of Technology group.



Figure 4 A representation of the typical random phase separaiton structure of polymer blend systems.

と、2009年の論文中でケミカルエピタキシーを利用して500 nm程度のパターニングに成功している¹⁵⁾.しかし、ラフネ スが大きく実用化には厳しい結果と言わざるを得ない(図 5).故に、ポリマーブレンド型DSAで微細パターニングを 実現するには高度に精錬された「誘導」技術と材料が要求 される.ポリマーブレンド型DSAによる微細パターニングは



Figure 5 An example of the polymer-blend DSA by University of Massachusetts group. The scale bar is 1μ m.

簡単ではない反面,いくつかの魅力的側面も持ち合わせ ている.パターンサイズは分子鎖長ではなく,2つのポリ マー成分の混合体積比で決まるため,ポリマー生産時の 「ぶれ」の影響は低減されうる.また,低温ベークやウェット 現像も可能であり,プロセスコストの低減にも繋がる.原理 上,いかなるポリマーも適用可能であるため,材料選択幅 も非常に広い.

そこで、本論文では著者らが成功したポリマーブレンド型DSAによる微細パターニングについて紹介する.なお、本研究はIBM社との共同研究に基づく成果である.

2 実験

2.1 パターニング手法

有機下層膜上にJSR製ArFフォトレジストを用いて26nm ライン88nmピッチのガイドパターンを作成した.そこに, DSA材料として親水性ポリマーと疎水性ポリマーの混合溶 液からなるJSR DS005Xをスピン塗布し,続いて60秒間 ベークすることで相分離を促した.さらに,ガイドパターン と疎水性ポリマーを選択除去することで,親水性ポリマー から成るDSAパターンを形成した(図6).

2.2 装置

ガイドパターンおよびDSA材料の塗布,ベーク,現像は 東京エレクトロン社製の「CREAN TRACK LITHIUS Pro-i」を使用した.ガイドパターン作成時の露光にはニコ ン社製の「NSR-S610C」を使用した.また,パターンの観 測には日立ハイテクノロジー社製の「CG4100」および「S-4800」を使用した.観測時の加速電圧はそれぞれ500Vお よび5000Vを用いた.

3 結果と考察

26nmライン88nmピッチのガイドパターン(図7a)上に DSA材料をスピン塗布し、ベークした後に断面SEM観測 を行なった(図7b).塗布ムラのない良好な埋め込み性が 確認された.また,DSA材料がガイドパターン上に薄く堆 積していることも確認された.ガイドパターンのスペース内 部において,親水性ポリマーがガイドパターン側壁に付着 し,その間に疎水性ポリマー入り込む形で相分離が進行 していることが期待される.そこで,相分離構造を確認す べく疎水性ポリマーの選択除去を実施した(図7c).結 果,スカムもなく理想的な相分離構造を有していることが確 認された.Line Width Roughness(LWR)を3oで測定し たところ,ガイドパターンでは4.8nmであったのに対し,図 7cの状態では5.1nmであった. ガイドパターンのラフネス が比較的良く転写されていた. すなわち, ガイドパターン のラフネスを低減することが, 自己組織化パターンのラフネ ス低減に繋がるものと考えられる. 続いて, ガイドパターン の除去を実施した(図7d). 結果, 親水性ポリマーからな る微細パターンが確認された. 線幅は19nm, 線幅のばら つきは1.1nm(3o)であった. LWRは3.5nmであり, 疎水 性ポリマーの除去前後で劣化は見られなかった.

特筆すべきはマイクロメーター領域においてパターン倒れ



Figure 6 Process flow of this work. (a) Guide patterns prepared by ArF immersion lithography. (b) Ascoated state formed by polymer blend solution. (c) Phase separation state formed by baking. (d) DSA patterns obtained by selective removal of guide patterns and hydrophobic polymer.



Figure 7 SEM images of each process step. (a) Guide patterns on spin-on carbon layer. (b) As-coated state formed by polymer blend solution. (c) Enlarged guide patterns formed by hydrophilic polymer attachment. (d) DSA patterns obtained by selective removal of guide patterns and hydrophobic polymer.



Figure 8 A top-down SEM image corresponding to Figure 7-(d) in µm range.

や直線配向からの逸脱(disorder欠陥)が見られなかった 点である(図8).ブロックコポリマー型DSAでは直線配向 の一部が突如,指紋様に歪むdisorder欠陥がしばしば観 測される.これはDSA特有の欠陥として知られ,現在に おいても最も大きな課題の一つとして注目されている.Disorder欠陥が発現する一因は,ブロックコポリマーが有す る規則的なミクロ相分離能と考えられる.既述のとおり,ポ リマーブレンドにはそのような機能が備わっていないため, 原理的に発現しないものと考えられる.

ポリマーブレンド型DSAは側壁プロセスの一種という解 釈も可能である.様々な側壁プロセスが提案されている が,代表的なものはCVDプロセスと反応性材料を用いた スピンオンプロセスの二つであろう.前者は非常に良好な ラフネスを与える反面,CVD装置が必須となるためコスト が割高となる.後者はプロセスが簡便な反面,反応性骨 格の導入,微細領域での反応制御という制約がある.ポ リマーブレンド型DSAはCVD装置も反応性も必要とせず, 極めて簡便な第三の手法となりうる.

4 まとめ

親水性ポリマーと疎水性ポリマーの混合溶液からなるポ リマーブレンド型DSA薬液を用いて19nm線幅のパターニ ングに成功した.線幅のばらつきは1.1nm, LWRは3.5 nmであり良好な性能を示した. 生産時の「ぶれ」幅許容値の向上、オントラック化や温和な ベーク条件によるプロセスコストの低減、重合法や化学構造 にとらわれない材料選択幅の広さ等、ポリマーブレンド型 DSAは大きな魅力を秘めている.さらに、倒れやdisorder 欠陥も見られず、欠陥の面でも優位性がみられた.ポリ マーブレンド型DSAは、更なる性能改善によって次世代リ ソグラフィーの一端を担うポテンシャルを秘めているものと考 える.

謝辞

本研究を進めるにあたり有益な助言と多くの技術的御協 力を賜りましたIBMリサーチグループメンバーおよびJSR Micro, Inc.のテクニカルグループメンバーに深く感謝いた します.

発表先

- 1) SPIE Advanced Lithography 2011, 7972–28.
- NGL2011次世代リングラフィワークショップ予稿集,p
 24.

引用文献

- Y. Mogi, H. Kotsuji, Y. Kaneko, K. Mori, Y. Matsushita, I. Noda: *Macromolecules*, 25, 5408(1992).
- 2) J. Suzuki, M. Seki, Y. Matsushita: J. Chem. Phys.,

112, 4862 (2000).

- K. Hayashida, A. Takano, S. Arai, Y. Shinohara, Y. Amemiya, Y. Matsushita: *Macromolecules*, **39**, 9402(2006).
- T. Asari, S. Matsuo, A. Takano, Y. Matsushita: *Polym. J.*, **38**, 258 (2006).
- J. Matsuda, Y. Nagata, A. Noro, A. Takano, Y. Matsushita: *Phys. Rev. Lett.*, **97**, 098301 (2006).
- Y. Matsushita, J. Suzuki, Y. Izumi, K. Matsuoka, S. Takahashi, Y. Aoyama, T. Mihira, A. Takano: *J. Chem. Phys.*, **133**, 194901 (2010).
- H. -C. Kim, S. -M. Park, W. D. Hinsberg: *Chem. Rev.*, **110**, 146 (2010).
- K. Hayashida, A. Takano, T. Dotera, Y. Matsushita: *Phys. Rev. Lett.*, **98**, 195502 (2007).
- 9) M. Park, C. Harrison, P. M. Chaikin, R. A. Regis-

ter, D. H. Adamson: Science, 276, 1401 (1997).

- M. W. Matsen, F. S. Bates: J. Chem. Phys., 106, 2436 (1997).
- M. J. Fasolka, A. M. Mayes: Annu. Rev. Mater. Res., 31, 323 (2001).
- C. Park, J. Yoon, E. L. Thomas: *Polymer*, 44, 6725 (2003).
- J. Y. Cheng, A. M. Mayes, C. A. Ross: *Nature Materials*, 3, 823 (2004).
- 14) J. K. W. Yang, Y. S. Jung, J.-B. Chang, R. A. Mickiewicz, A. Alexander-Kats, C. A. Ross, K. K. Berggren: *Nature Nanotechnology*, 5, 256 (2010).
- 15) M. Wei, L. Fang, J. Lee, S. Somu, X. Xiong, C. Barry, A. Busnaina, J. Mead: *Adv. Mater.*, **21**, 794 (2009).